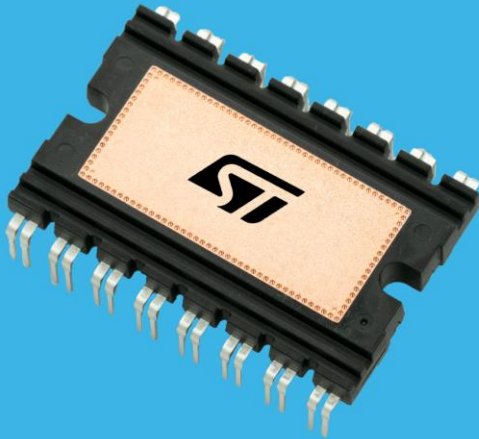




life.augmented

新聞稿



ACEPACK DMT-32 SiC based molded module  
Flexible, compact and reliable solution



## 意法半導體車規雙列直插碳化矽功率模組提供多功能封裝配置

【臺北訊，2023年12月14日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出ACEPACK<sup>1</sup> DMT-32系列車規碳化矽（SiC）功率模組，新系列產品採用便利的32腳位雙列直插通孔塑膠封裝，目標應用為車載充電器（OBC）、DC / DC直流變壓器、油液幫浦、空調等汽車系統，產品優勢包括高功率密度、小尺寸設計和裝配簡易等，其提供四管全橋、三相六管全橋和圖騰柱三種封裝配置，強化了系統設計的彈性。

新模組內建1200V SiC功率開關二極體，而其搭配之意法半導體第二代和第三代SiC MOSFET先進技術確保碳化矽開關二極體具有低導通電阻 $R_{DS(on)}$ 。模組還具備高效的開關性能，將溫度影響降至最低，確保功率轉換系統的高效能和可靠性。

因為採用意法半導體經過驗證之穩定的ACEPACK封裝技術，這些模組降低了整體系統和設計的開發成本，同時確保可靠性。該封裝技術採用高性能氮化鋁（Aluminum Nitride，AlN）絕緣基板，具有出色的導熱性能。在封裝內另有一個NTC溫度感測器，為導熱保護機制提供溫度監測資訊。

本次推出的M1F45M12W2-1LA是ACEPACK DMT-32系列的首款產品，從2023年第四季開始量產。M1F80M12W2-1LA、M1TP80M12W2-2LA、M1P45M12W2-1LA、M1P80M12W2-1LA、

<sup>1</sup> ACEPACK: Adaptable Compact Easier PACKage

M1P30M12W3-1LA 從樣片現已上市，將於2024年第一季量產。

更多資訊請瀏覽：<http://www.st.com/acepack-dmt-32>。

### 關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商 ( IDM )，意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和 ( 適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3 ) 之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：[www.st.com](http://www.st.com)。